

## 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议、于2026年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下：

### 一、信用减值及资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计29,553,770.27元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	2025年1-12月 计提减值准备金额	备注
1	信用减值准备	25,841,866.34	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值准备	3,711,903.93	存货跌价准备、合同资产减值准备
合计		29,553,770.27	

### 二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明

#### （一）计提信用减值准备的依据及说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他

应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年1-12月公司计提信用减值准备25,841,866.34元。

## （二）计提资产减值准备的依据及说明

### 1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司对截至2025年12月31日的存货项目进行了减值测试，2025年1-12月计提存货跌价准备3,606,663.18元。

### 2、合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对截至2025年12月31日的合同资产进行了减值测试，2025年1-12月公司计提合同资产减值准备105,240.75元。

### 3、固定资产、无形资产等长期资产减值

公司对存在减值迹象的固定资产、无形资产等长期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可回收金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。公司对截至2025年12月31日的固定资产、无形资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试，固定资产、无形资产等长期资产无需计提减值准备。

## 三、对公司的影响

2025年1-12月，公司计提信用及资产减值准备合计29,553,770.27元，预计将减少公司2025年1-12月利润总额29,553,770.27元。公司2025年1-12月计提的减值准备已经会计师事务所审计。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策要求，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日

的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

#### **四、本次计提信用及资产减值准备的审议程序**

本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并经公司第二届董事会第二十六次会议通过。

##### **（一）董事会审计委员会意见**

审计委员会认为：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

##### **（二）董事会意见**

公司董事会认为：公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026年3月11日